

Rec'd PCT/PTO 19 JAN 2005
PCT/JP 03/10020
09.10.03

19/02

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年 8月 8日

REC'D 27 NOV 2003

出願番号
Application Number: 特願 2002-230844

WIPO PCT

[ST. 10/C]: [JP 2002-230844]

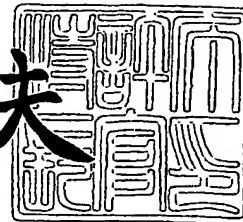
出願人
Applicant(s): 大日本印刷株式会社

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1 (a) OR (b)

2003年11月13日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願
【整理番号】 5802080602
【提出日】 平成14年 8月 8日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 H01J 11/02
G12B 17/02
H05K 9/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1番 1号 大日本印刷株
式会社内

【氏名】 荒川 文裕

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1番 1号 大日本印刷株
式会社内

【氏名】 石井 康英彦

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1番 1号 大日本印刷株
式会社内

【氏名】 橋本 大祐

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1番 1号 大日本印刷株
式会社内

【氏名】 京田 享博

【発明者】

【住所又は居所】 東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1番 1号 大日本印刷株
式会社内

【氏名】 大石 英司

【特許出願人】

【識別番号】 000002897

【氏名又は名称】 大日本印刷株式会社

【代理人】

【識別番号】 100111659

【弁理士】

【氏名又は名称】 金山 聰

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013055

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9808512

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電磁波遮蔽用シート

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 透明基材の一方の面へ、接着剤を介して、メッシュ部と該メッシュ部に外周する接地用枠部とを有する金属層が積層された電磁波遮蔽用シートにおいて、前記メッシュ部と前記接地用枠部との間にメッシュ外周部を有し、該メッシュ外周部のラインのライン幅が、メッシュ部から接地用枠部に向かって暫時拡幅されてなることを特徴とする電磁波遮蔽用シート。

【請求項 2】 上記メッシュ外周部が、接地用枠部の内周から 1～50 メッシュ、又は 0.15～1.5 mm であることを特徴とする請求項 1 記載の電磁波遮蔽用シート。

【請求項 3】 上記メッシュ外周部が、接地用枠部の内周から 1～25 メッシュ、又は 0.3～7.5 mm であることを特徴とする請求項 1 記載の電磁波遮蔽用シート。

【請求項 4】 上記ライン幅の暫時拡幅が、連続的、又は段階的であることを特徴とする請求項 1～3 のいずれかに記載の記載の電磁波遮蔽用シート。

【請求項 5】 上記金属層の少なくとも一方の面へ黒化処理をしてなることを特徴とする請求項 1～4 のいずれかに記載の電磁波遮蔽用シート。

【請求項 6】 上記金属層の少なくとも黒化処理面へ防錆層を設けたことを特徴とする請求項 1～5 のいずれかに記載の電磁波遮蔽用シート。

【請求項 7】 上記メッシュ部の金属層の少なくとも開口部を樹脂で充填して、金属層面が実質的に平坦化状態であることを特徴とする請求項 1～6 のいずれかに記載の電磁波遮蔽用シート。

【請求項 8】 上記メッシュ部の金属層の少なくとも開口部を充填して、実質的に平坦化させる樹脂へ、可視及び／又は近赤外線の特定波長光を吸収する光線吸収剤を含有することを特徴とする請求項 7 に記載の電磁波遮蔽用シート。

【請求項 9】 少なくとも一方の面へ、可視及び／又は近赤外線の特定波長光を吸収する光線吸収剤層を設けることを特徴とする請求項 7 に記載の電磁波遮蔽用シート。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、電磁波を遮蔽（シールドともいう）用のシートに関し、さらに詳しく述べて、CRT、PDPなどのディスプレイの前面に配置して、ディスプレイから発生する電磁波を遮蔽し、かつ、ディスプレイの画像を良好に視認でき、かつ、電磁波遮蔽用シートの製造からディスプレイへの組立まで全工程において、ロールでの搬送時においても折り曲げに強く、接地用枠部とメッシュ部の境界で断線の発生が少なく、ハンドリング適性に優れる電磁波遮蔽用シートに関するものである。

【0002】

【従来技術】

（技術の概要）近年、電気電子機器の機能高度化と増加利用に伴い、電磁気的なノイズ妨害（Electro Magnetic Interference；EMI）が増えている。電磁波ノイズは大きく分けて伝導ノイズと放射ノイズがある。伝導ノイズはノイズフィルタなどを用いる方法がある。一方、放射ノイズは電磁気的に空間を絶縁するため、筐体を金属にしたり、回路基板間に金属板を挿入したり、ケーブルを金属箔で巻きなどの方法がある。これらの方法は回路や電源ブロックの電磁波遮蔽の効果はあるが、CRT、プラズマディスプレイパネル（PDPという）などの、ディスプレイ前面より発生する電磁波遮蔽用には、不透明であるため適さない。

プラズマディスプレイパネルは、データ電極と蛍光層を有するガラスと透明電極を有するガラスとの組合体であり、作動すると電磁波、近赤外線、及び熱が大量に発生する。通常、電磁波を遮蔽するためにプラズマディスプレイパネルの前面に前面板を設ける。ディスプレイ前面から発生する電磁波の遮蔽性は、30MHz～1GHzにおける30dB以上の機能が必要である。また、ディスプレイ前面より発生する波長800～1,100nmの近赤外線も、他のVTRなどの機器を誤作動させるので、遮蔽する必要がある。さらに、ディスプレイの表示画像を視認しやすくするため、電磁波遮蔽用の金属メッシュ（ライン部）部分が見

えにくく、また、メッシュの乱れがなく、電磁波遮蔽用シートとしては適度な透明性（可視光透過性、可視光透過率）を有することが必要である。

さらにまた、プラズマディスプレイパネルは大型画面を特徴としており、電磁波遮蔽用シートの大きさ（外形寸法）は、例えば、37型では $621 \times 831\text{mm}$ 、42型では $983 \times 583\text{mm}$ もあり、さらに大型サイズもある。このため、電磁波遮蔽用シートの製造からディスプレイへの組立まで全工程において、接地用枠部とメッシュ部の境界が断線したりしやすく、ハンドリング適性が極めて悪かった。

【0003】

（先行技術）前面板は、電磁波遮蔽と適度な透明性（可視光の透過率）を有し、かつ、優れたハンドリング適性が求められている。

ディスプレイ画像の視認性を向上させるために、基板／透明アンカ層／メッシュパターン状の無電解メッキ層からなり、無電解メッキにより無電解メッキ層下の透明アンカ層が黒色パターン部に変えられている電磁波シールド材料が、特開平5-283889号公報で開示されている。また、電磁波遮蔽シートの金属メッシュの表面に酸化銅被膜を形成して、外光の反射を押さえる方法が、特開昭61-15480号公報で開示されている。また、電磁波遮蔽シートの金属メッシュをフォトレジスト法で形成する際に用いた黒色レジストを、メッシュを開孔した後もそのまま残存させて、メッシュの枠部分（ラインに相当する）を黒くしておく方法が、特開平09-293989号公報で開示されている。さらには、銅箔に幾何学図形をフォトリソグラフィ法で形成した銅箔付きプラスチックフィルムをプラスチック板に積層した電磁波遮蔽構成体が、特開平10-335885号公報で開示されている。しかしながら、メッシュ状の金属層を用いる上記のいずれの方法でも、金属メッシュのライン幅は一定を目標としているが、実際のメッシュと接地用枠部101との境界部に位置する、メッシュ外周部におけるメッシュ及びラインの乱れの発生は、特に搬送時では免れない。また、メッシュ部103と接地用枠部101との境界は剛度が極端に違うので、電磁波遮蔽用シートの製造工程からディスプレイへの組立、組付まで全工程において、折れ曲がったり、断線したりして、ハンドリング適性が極めて悪く、高価な部品を無駄にす

るという欠点がある。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

そこで、本発明はこのような問題点を解消するためになされたものである。その目的は、C R T、P D Pなどのディスプレイの前面に配置して、ディスプレイから発生する電磁波を遮蔽し、メッシュの乱れがなくて、ディスプレイ画像を良好に視認性でき、かつまた、大型の電磁波遮蔽用シートでも製造から組立までの全工程で折れなどの不良が発生せずハンドリング適性に優れた電磁波遮蔽用シートを提供することである。

【0005】

【課題を解決するための手段】

上記の課題を解決するために、請求項1の発明に係わる電磁波遮蔽用シートは、透明基材の一方の面へ、接着剤を介して、メッシュ部と該メッシュ部に外周する接地用枠部とを有する金属層が積層された電磁波遮蔽用シートにおいて、前記メッシュ部と前記接地用枠部との間にメッシュ外周部を有し、該メッシュ外周部のラインのライン幅が、メッシュ部から接地用枠部に向かって暫時拡幅されてなるように、したものである。本発明によれば、C R T、P D Pなどのディスプレイの前面に配置して、ディスプレイから発生する電磁波を遮蔽し、メッシュの乱れがなくて、ディスプレイ画像を良好に視認性でき、かつまた、大型の電磁波遮蔽用シートでも製造から組立までの全工程で折れなどの不良が発生せずハンドリング適性に優れた電磁波遮蔽用シートが提供される。

請求項2の発明に係わる電磁波遮蔽用シートは、上記メッシュ外周部が、接地用枠部の内周から1～50メッシュ、又は0.15～15mmであるように、請求項3の発明に係わる電磁波遮蔽用シートは、上記メッシュ外周部が、接地用枠部の内周から1～25メッシュ、又は0.3～7.5mmであるように、請求項4の発明に係わる電磁波遮蔽用シートは、上記ライン幅の暫時拡幅が、連続的、又は段階的であるように、したものである。本発明によれば、メッシュ外周部と接地用枠部との間で極端に違う剛度が、徐々に変化することで大幅に緩和されて、電磁波遮蔽用シートの製造工程からディスプレイへの組立、組付まで全工程に

において、ハンドリング適性が極めてよく、折れ曲がったり、折りくせが発生せず、高価な部品を無駄にすることがない電磁波遮蔽用シートが提供される。

請求項5の発明に係わる電磁波遮蔽用シートは、上記金属層の少なくとも一方の面へ黒化処理をしてなるように、請求項6の発明に係わる電磁波遮蔽用シートは、上記金属層の少なくとも黒化処理面へ防錆層を設けるように、したものである。本発明によれば、メッシュ自体が黒く、錆びにくく、ディスプレイ画像を長期間にわたって良好に視認性できる電磁波遮蔽用シートが提供される。

請求項7の発明に係わる電磁波遮蔽用シートは、上記メッシュ部の金属層の少なくとも開口部を樹脂で充填して、金属層面が実質的に平坦化状態であるように、したものである。本発明によれば、開口部の凹凸が埋まって作業性に優れる電磁波遮蔽用シートが提供される。

請求項8の発明に係わる電磁波遮蔽用シートは、上記メッシュ部の金属層の少なくとも開口部を充填して、実質的に平坦化させる樹脂へ、可視及び／又は近赤外線の特定波長光を吸収する光線吸収剤を含有するように、請求項9の発明に係わる電磁波遮蔽用シートは、少なくとも一方の面へ、可視及び／又は近赤外線の特定波長光を吸収する光線吸収剤層を設けるように、したものである。本発明によれば、PDPディスプレイから発生する近赤外線、赤外線及び電磁波を遮蔽し、ディスプレイ画像を良好に視認することができる電磁波遮蔽用シートが提供される。

さらに、請求項1～8の発明に係わる電磁波遮蔽用シートは、基材面をPDPディスプレイ側へ設置してもよく、電極の引き出し工数も減り、額縁状の黒印刷も要らず、画像の視認性はギラツキもなく、良好である電磁波遮蔽用シートが提供される。

【0006】

【発明の実施の形態】

本発明の実施態様について、図面を参照して詳細に説明する。

図1は、本発明の電磁波遮蔽用シートの平面図である。

図2は、本発明の電磁波遮蔽用シートの一部を模式的に示す斜視図である。

(全体の構成) 図1に示すように、本発明の電磁波遮蔽用シート1は、メッシ

ュ部103と接地用枠部101とからなっている。接地用枠部101はディスプレイへ設置した場合にアースがとられる。

メッシュ部103は、図2に示すように、ライン107で囲まれた複数の開口部（セルともいう）105からなっている。メッシュ部103と接地用枠部101との間に、メッシュ外周部104を有する。そして、該メッシュ外周部104のラインのライン幅が、メッシュ部から接地用枠部に向かって暫時拡幅されている。

また、基材11の一方の面へ接着剤層13を介して導電材層109が積層されている。該導電材層109は開口部105が密に配列したメッシュ状であり、該メッシュは開口部105と枠をなしているライン107から構成されている。ライン部107の幅は、図2に示すようにライン幅Wと称し、ラインとラインとの間隔をピッチPと称する。

【0007】

図3は、図2のAA断面図、及びBB断面図である。

図4は、導電材層の構成を説明する断面図である。

（層の構成）図3（A）は開口部を横断する断面を示し、開口部105とライン107が交互に構成され、図3（B）はライン107の断面を示し、導電材層109からなるライン107が連続して形成されている。導電材層109は、金属層21で、少なくとも観察面には黒化処理23A又は23Bを行う。さらに、黒化処理23A及び／又は23Bを覆うように、防錆層25A及び／又は25Bを設けるが、防錆層は少なくとも黒化処理側に設ければよい。

該防錆層25A、25Bは金属箔21及び黒化処理23A、23Bの防錆機能を持ち、かつ、黒化処理23A、23Bの脱落も防止する。また、驚くべきことに、該防錆層25A及び25Bは、基材11と接着剤層13を介して積層した後は、該接着剤層13をも保護するのである。さらに、必要に応じて、金属層21の他方の面へも、黒化処理23B及び防錆層25Bを設けてもよく、両面へ黒化処理23A、23B及び防錆層25A、25Bを設けてもよい。要は、少なくとも観察側へ黒化処理及び防錆層を設け、基材11側へは防錆層25Aを必須に設ける。

【0008】

(発明のポイント)

そして、本発明の電磁波遮蔽用シート1では、メッシュ部103と接地用枠部101との間にあるメッシュ外周部104における、ライン107の直線部におけるライン幅Wが、メッシュ部103から接地用枠部101に向かって暫時大きくなるようにする。

該メッシュ外周部104としては、接地用枠部101の内周からメッシュ外周部104が、接地用枠部101の内周から1～50メッシュ、又は0.15～1.5mm程度、好ましくは1～25メッシュ、又は0.3～7.5mm、さらに好ましくは3～20メッシュ、又は1.5～6.0mmである。ライン幅の暫時拡幅は、連続的、又は段階的でもよい。このようにすると、メッシュ外周部104と接地用枠部101とで極端に違う剛度が、徐々に変化することで大幅に緩和される。電磁波遮蔽用シートの製造工程からディスプレイへの組立、組付まで全工程において、ハンドリング適性が極めてよく、折れ曲がったり、折りくせがつたり、接地用枠部とメッシュ部の境界で断線することがなく、高価な部品を無駄にすることがない。

本明細書では、本発明の電磁波遮蔽用シートをCRT、PDPなどのディスプレイ用を主体に記載しているが、ディスプレイ以外の電磁波遮蔽用に使用できることはいうまでもない。

【0009】

一方、プラズマディスプレイパネルは大型画面を特徴としており、電磁波遮蔽用シートの大きさ（外形寸法）は、例えば、37型では620×830mm程度、42型では580×980mm程度もあり、さらに大型サイズもある。このため、電磁波遮蔽用シートの製造工程からディスプレイへの組立、組付まで全工程において、ハンドリング適性は極めて重要である。従来の電磁波遮蔽用シートでは、接地用枠部とメッシュ部の境界で断線したり、折れ曲がったりして、高価な部品を無駄にすることがあった。

【0010】

本発明の電磁波遮蔽用シートの導電材部109としては、金属箔21の少なく

とも一方の面へ黒化処理23A及び／又は23Bを設け、さらに、該黒化処理23A及び／又は23Bの少なくとも黒化処理面へ、防錆層25A及び／又は25Bが設けられている。

該導電材部109を接着剤を介して透明基材フィルム11と積層した後に、フォトリソグラフィ法でメッシュ状とする。必要に応じて、金属箔側を平坦化し、さらに必要に応じて特定波長の可視及び／又は近赤外線を吸収する光線吸収剤層を設ける。このような電磁波遮蔽用シートをディスプレイの前面に配置すると、ディスプレイから発生する電磁波を遮蔽し、メッシュの濃淡ムラがなく、黒又は白の点状線状の欠点が極めて少なく、かつ、適度の透明性を有し、ディスプレイに表示された画像を良好に視認することができる。

【0011】

(製造方法の概略) 本発明の電磁波遮蔽用シート1は、まず、少なくとも観察側に、黒化処理及び防錆層を設けた導電材層109を用意し、該導電材層109を透明なフィルム状の基材11の一方の面へ接着剤を介して積層した後に、導電材層109面へレジスト層をメッシュパターン状に設け、レジスト層で覆われていない部分の導電材層109をエッチングにより除去した後に、レジスト層を除去する所謂フォトリソグラフィ法で製造すればよい。さらに、既存の設備を使用でき、これらの製造工程の多くを連続的に行うことで、品質及び歩留まりが高く、生産効率が高く生産できる。

【0012】

本発明の電磁波遮蔽用シート1の、各層の材料及び形成について説明する。

(導電材層) 電磁波を遮蔽する導電材層109としては、例えば金、銀、銅、鉄、ニッケル、クロムなど充分に電磁波をシールドできる程度の導電性を持つ金属箔21が適用できる。金属箔21は単体でなくても、合金あるいは多層であつてもよい。、金属箔21としては、鉄の場合には低炭素リムド鋼や低炭素アルミキルド鋼などの低炭素鋼、Ni-Fe合金、インバー合金が好ましく、また、カソーディック電着を行う場合には、電着のし易さから銅又は銅合金箔が好ましい。該銅箔としては、圧延銅箔、電解銅箔が使用できるが、厚さの均一性、黒化処理及び／又はクロメート(処理)層との密着性、及び10μm以下の薄膜化がで

きる点から、電解銅箔が好ましい。該金属箔21の厚さは1～100μm程度、好ましくは5～20μmである。これ以下の厚さでは、フォトリソグラフィ法によるメッシュ加工は容易になるが、金属の電気抵抗値が増え電磁波遮蔽効果が損なわれ、これ以上では、所望する高精細なメッシュの形状が得られず、その結果、実質的な開口率が低くなり、光線透過率が低下し、さらに視角も低下して、画像の視認性が低下する。

【0013】

金属箔21の表面粗さとしては、Rz値で0.5～10μmが好ましい。これ以下では、黒化処理しても外光が鏡面反射して、画像の視認性が劣化する。これ以上では、接着剤やレジストなどを塗布する際に、表面全体へ行き渡らなかったり、気泡が発生したりしてする。表面粗さRzは、JIS-B0601に準拠して測定した10点の平均値である。

【0014】

(黒化処理) 電磁波遮蔽用シート1への外光を吸収させて、ディスプレイの画像の視認性を向上するために、メッシュ状の導電材部109の観察側に黒化処理を行って、コントラスト感を出すことが必要である。該黒化処理は金属箔面を粗化及び／又は黒化すればよく、金属酸化物、金属硫化物の形成や種々の手法が適用できる。鉄の場合には、通常スチーム中、450～470℃程度の温度で、10～20分間さらして、1～2μm程度の酸化膜(黒化膜)を形成するが、濃硝酸などの薬品処理による酸化膜(黒化膜)でもよい。また、銅箔の場合には、銅箔を硫酸、硫酸銅及び硫酸コバルトなどからなる電解液中で、陰極電解処理を行って、カチオン性粒子を付着させるカソーディック電着が好ましい。該カチオン性粒子を設けることでより粗化し、同時に黒色が得られる。記カチオン性粒子としては、銅粒子、銅と他の金属との合金粒子が適用できるが、好ましくは銅-コバルト合金の粒子である。

【0015】

本明細書では、粗化及び黒色化を合わせて黒化処理という。該黒化処理の好ましい黒濃度は0.6以上である。なお、黒濃度の測定方法は、COLOR CONTROL SYSTEMのGRETAG SPM100-11(キモト社製、

商品名）を用いて、観察視野角10度、観察光源D50、照明タイプとして濃度標準ANSI Tに設定し、白色キャリブレーション後に、試験片を測定する。また、該黒化処理の光線反射率としては5%以下が好ましい。光線反射率は、JIS-K7105に準拠して、ハイズメーターHM150（村上色彩社製、商品名）を用いて測定する。

【0016】

（合金粒子）上記カチオン性粒子としては、銅粒子、銅と他の金属との合金粒子が適用できるが、好ましくは銅-コバルト合金の粒子である。銅-コバルト合金の粒子を用いると、黒化の程度が著しく向上して可視光をよく吸収する。電磁波遮蔽用シートの視認性を評価する光学特性として、色調をJIS-Z8729に準拠した表色系「L*、a*、b*、ΔE*」で表わした。該「a*」及び「b*」の絶対値が小さい方が導電材部109が非視認性となり、画像のコントラスト感が高まり、結果として画像の視認性が優れる。銅-コバルト合金の粒子を用いると、銅粒子と比較して「a*」及び「b*」をほぼ0に近く小さくできる。

【0017】

また、銅-コバルト合金粒子の平均粒子径は0.1~1μmが好ましい。これ以上では、銅-コバルト合金粒子の粒子径を大きくすると金属箔21の厚さが薄くなり、基材11と積層する工程で銅箔が切断したりして加工性が悪化し、また、密集粒子の外観の緻密さが欠けて、ムラ状が目立ってくる。これ以下では、粗化が不足するので、画像の視認性が悪くなる。

【0018】

（防錆層）金属箔21及び/又は黒化処理への、防錆機能と黒化処理の脱落や変形を防止するために、少なくとも黒化処理を有する金属箔面へ、防錆層25A及び/又は25Bを設ける。該防錆層25A、25Bとしては、ニッケル及び/又は亜鉛及び/又は銅の酸化物、又はクロメート処理層が適用できる。ニッケル及び/又は亜鉛及び/又は銅の酸化物の形成は、公知のメッキ法でよく、厚さとしては、0.001~1μm程度、好ましくは0.001~0.1μmである。

【0019】

（クロメート）該クロメート処理は、被処理材へクロメート処理液を塗布し処

理する。該塗布方法としては、ロールコート、カーテンコート、スライズコート、静電霧化法、浸漬法などが適用でき、塗布後は水洗せずに乾燥すればよい。クロメート処理を片面に施す場合は、ロールコートなどで片面に塗布し、両面に施す場合は、浸漬法で行えばよい。クロメート処理液としては、通常CrO₂を3g／lを含む水溶液を使用する。この他、無水クロム酸水溶液に異なるオキシカルボン酸化合物を添加して、6価クロムの一部を3価クロムに還元したクロメート処理液も使用できる。また、6価クロムの付着量の多少により淡黄色から黄褐色に着色するが、3価クロムは無色であり、3価と6価クロムを管理すれば、実用上の問題がない透明性が得られる。オキシカルボン酸化合物としては、酒石酸、マロン酸、クエン酸、乳酸、グルコール酸、グリセリン酸、トロバ酸、ベンジル酸、ヒドロキシ吉草酸などを、単独又は併用して用いる。還元性は化合物により異なるので、添加量は3価クロムへの還元を把握しながら行う。

具体的には、アルサーフ1000（日本ペイント社製、クロメート処理剤商品名）、PM-284（日本パーカライジング社製、クロメート処理液商品名）などが例示できる。また、クロメート処理は黒化処理の効果をより高める。

【0020】

黒化処理及び防錆層層は、少なくとも観察側に設ければよく、コントラストが向上してディスプレイの画像の視認性が良くなる。また、他方の面、即ちディスプレイ面側に設けてもよく、ディスプレイから発生する迷光を抑えられるので、さらに、画像の視認性が向上する。

【0021】

次に、該防錆層の少なくとも黒化処理面へ、透明な基材を接着剤で積層する。

（基材）基材11の材料としては、使用条件や製造に耐える透明性、絶縁性、耐熱性、機械的強度などがあれば、種々の材料が適用できる。例えば、ポリエチレンテレフタレート・ポリブチレンテレフタレート・ポリエチレンナフタレート・ポリエチレンテレフタレート-イソフタレート共重合体・テレフタル酸-シクロヘキサンジメタノール-エチレングリコール共重合体・ポリエチレンテレフタレート/ポリエチレンナフタレートの共押し出しフィルムなどのポリエステル系樹脂、ナイロン6・ナイロン66・ナイロン610などのポリアミド系樹脂、ポ

リプロピレン・ポリメチルペンテンなどのポリオレフィン系樹脂、ポリ塩化ビニルなどのビニル系樹脂、ポリアクリレート・ポリメタアクリレート・ポリメチルメタアクリレートなどのアクリル系樹脂、ポリイミド・ポリアミドイミド・ポリエーテルイミドなどのイミド系樹脂、ポリアリレート・ポリスルホン・ポリエーテルスルホン・ポリフェニレンエーテル・ポリフェニレンスルフィド（P P S）・ポリアラミド・ポリエーテルケトン・ポリエーテルニトリル・ポリエーテルエーテルケトン・ポリエーテルサルファイトなどのエンジニアリング樹脂、ポリカーボネート、A B S樹脂などのスチレン系樹脂などがある。

【0022】

該基材は、これら樹脂を主成分とする共重合樹脂、または、混合体（アロイでを含む）、若しくは複数層からなる積層体であっても良い。該基材は、延伸フィルムでも、未延伸フィルムでも良いが、強度を向上させる目的で、一軸方向または二軸方向に延伸したフィルムが好ましい。該基材の厚さは、通常、12～1000 μm 程度が適用できるが、50～700 μm が好適で、100～500 μm が最適である。これ以下の厚さでは、機械的強度が不足して反りやたるみなどが発生し、これ以上では、過剰な性能となってコスト的にも無駄である。

該基材は、これら樹脂の少なくとも1層からなるフィルム、シート、ボード状として使用するが、これら形状を本明細書ではフィルムと総称する。通常は、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート等のポリエステル系のフィルムが透明性、耐熱性がよくコストも安いので好適に使用され、ポリエチレンテレフタレートが最適である。また、透明性は高いほどよいが、好ましくは可視光線透過率で80%以上である。

【0023】

該基材フィルムは、塗布に先立って塗布面へ、コロナ放電処理、プラズマ処理、オゾン処理、フレーム処理、プライマー（アンカーコート、接着促進剤、易接着剤とも呼ばれる）塗布処理、予熱処理、除塵埃処理、蒸着処理、アルカリ処理、などの易接着処理を行ってもよい。該樹脂フィルムは、必要に応じて、充填剤、可塑剤、帯電防止剤などの添加剤を加えても良い。

【0024】

(積層法) 積層 (ラミネートともいう) 法としては、基材 11 又は導電材層 109 の一方に、接着剤又は粘着剤を塗布し必要に応じて乾燥して、加熱又は加熱しないで加圧する。その後必要に応じて 30~80℃ の温度下で、エージング (養生) してもよい。また、基材 11 自身、又は基材 11 が複数層で積層面が、例えば、アイオノマー樹脂、エチレン-酢酸ビニル共重合体、エチレン-アクリル酸共重合体、エチレン-アクリル酸エステル共重合体などの熱接着性の樹脂であれば、加熱下で加圧するだけでよい。

【0025】

(接着剤) 接着剤としては、特に限定されないが、例えば、アクリル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合樹脂などが適用できる。また、エッティング液による染色や劣化が少なく、加工適性のよい熱硬化型樹脂を用いた、当業者がドライラミネーション法 (ドライラミともいう) と呼ぶ方法が好ましい。さらに、紫外線 (UV) などの電離放射線で硬化 (反応) する UV 硬化型樹脂も好ましい。

【0026】

(ドライラミ) ドライラミネーション法とは、溶媒へ分散または溶解した接着剤を塗布し乾燥させて、貼り合せ基材を重ねて積層した後に、30~120℃で数時間~数日間エージングすることで、接着剤を硬化させることで、2種の材料を積層させる方法である。また、ドライラミネーション法を改良したノンソルベントラミネーション法でもよく、溶媒へ分散または溶解せずに接着剤自身を塗布し乾燥させて、貼り合せ基材を重ねて積層した後に、30~120℃で数時間~数日間エージングすることで、接着剤を硬化させることで、2種の材料を積層させる方法である。

【0027】

ドライラミネーション法、またはノンソルベントラミネーション法で用いる接着層の接着剤として、熱、または紫外線・電子線などの電離放射線で硬化する接着剤が適用できる。熱硬化接着剤としては、具体的には、2液硬化型の、ウレタン系接着剤、ポリエステルウレタン系接着剤、ポリエーテルウレタン系接着剤、アクリル系接着剤、ポリエステル系接着剤、ポリアミド系接着剤、ポリ酢酸ビニ

ル系接着剤、エポキシ系接着剤、ゴム系接着剤などが適用できるが、2液硬化型ウレタン系接着剤が好適である。

【0028】

該2液硬化型ポリウレタン系樹脂としては、具体的には、例えば、多官能イソシアネートとヒドロキシル基含有化合物との反応により得られるポリマー、具体的には、例えば、トリレンジイソシアート、ジフェニルメタンジイソシアート、ポリメチレンポリフェニレンポリイソシアート等の芳香族ポリイソシアート、あるいは、ヘキサメチレンジイソシアート、キシリレンジイソシアート等の脂肪族ポリイソシアート等の多官能イソシアネートと、ポリエーテル系ポリオール、ポリエステル系ポリオール、ポリアクリレートポリオール等のヒドロキシル基含有化合物との反応により得られる2液型ポリウレタン系樹脂を使用することができる。

好ましくは、エッティング液による染色、劣化がないスチレン・マレイン酸共重合ポリマーで変性したポリエステルポリウレタンと脂肪族ポリイシシアネートを配合した接着剤である。

【0029】

ドライラミネーション法では、これらを主成分とする接着剤組成物を有機溶媒へ溶解または分散し、これを、例えば、ロールコーティング、リバースロールコーティング、グラビアコーティング、グラビアリバースコーティング、グラビアオフセットコーティング、キスコーティング、ワイヤーバーコーティング、コンマコーティング、ナイフコーティング、デップコーティング、フローコーティング、スプレイコーティングなどのコーティング法で塗布し、溶剤などを乾燥して、本発明のラミネーション用接着層を形成することができる。好ましくは、ロールコーティング、リバースロールコーティング法である。

【0030】

該接着層の膜厚としては、0.1～20μm（乾燥状態）程度、好ましくは1～10μmである。該接着層を形成したら直ちに、貼り合せ基材を積層した後に、30～120℃で数時間～数日間エージングすることで、接着剤を硬化させることで接着する。該接着剤の塗布面は、基材側、導電材部側のいずれでもよい。

好ましくは、粗化してある銅箔側で、粗面の全体に行き渡って、積層体へ気泡の発生が抑えられる。

【0031】

ノンソルベントラミネーション法は、基本的にはドライラミネーション法と同様であるが、接着剤組成物を有機溶媒へ溶解または分散しないで、接着剤組成物そのままを用いるが、必要に応じて、粘度を低下させるために、接着剤組成物を加熱加温して用いる場合もある。

【0032】

(粘着剤) 粘着剤としては、公知の感圧で接着する粘着剤が適用できる。粘着剤としては、特に限定されるものではなく、例えば、天然ゴム系、ブチルゴム・ポリイソブレン・ポリイソブチレン・ポリクロロブレン・スチレン-ブタジエン共重合樹脂などの合成ゴム系樹脂、ジメチルポリシロキサンなどのシリコーン系樹脂、アクリル系樹脂、ポリ酢酸ビニール・エチレン-酢酸ビニール共重合体などの酢酸ビニール系樹脂、ウレタン系樹脂、アクリロニトリル、炭化水素樹脂、アルキルフェノール樹脂、ロジン・ロジントリグリセリド・水素化ロジンなどのロジン系樹脂が適用できる。

【0033】

(ゴム系粘着剤) ここでゴム系粘着剤は、クロロブレンゴム、ニトリルブタジエンゴム、アクリルゴム、スチレンブタジエンゴム、スチレンイソブレンスチレン、スチレンブタジエンスチレン、スチレンエチレンブタジエンスチレン、ブチルゴム、ポリイソブチレンゴム、天然ゴム、ポリイソブレンゴムなどの粘着ゴムの一又は複数に、フェノール系樹脂、変性フェノール樹脂、ケトン樹脂、アルキッド樹脂、ロジン系樹脂、クマロン樹脂、スチレン系樹脂、石油樹脂、塩化ビニル系樹脂などの粘着付与材の一又は複数を配合したものが有効である。

【0034】

(ゴム系粘着剤) ゴム系粘着剤は、アクリル系接着材と比較して耐薬品性、耐膨潤性、耐温度性、粘着性、および剥離強度に優れているので、接着部分が酸性又はアルカリ性の物質に曝されても剥離が生じない。また、ゴム系粘着材は、酸性又はアルカリ性の薬液中で加水分解をほとんど発生せず、粘着寿命が長い。

【0035】

(粘着剤層の形成) これらの樹脂、またはこれらの混合物を、ラテックス、水分散液、または有機溶媒液として、スクリーン印刷またはコンマコートなどの、公知の印刷またはコーティング法で、印刷または塗布し必要に応じて乾燥した後に、一方の材料と重ねて加圧すれば良い。

【0036】

図5は、巻取りロール状での加工を説明する平面図及び側面図である。

具体的な積層方法としては、通常、帯状で連続して巻き取られたロール状（巻取りロールという）で行う。図5（A）は平面図で巻取りロールから巻きほぐされて伸張された状態で、電磁波遮蔽用シート1が一定間隔で面付けされている。図5（B）は側面図で、導電材層109面と基材11とが積層されている。まず、巻取りロールの導電材層109へ、上記の黒化処理及び防錆層の形成をして、該防錆層へ接着剤を塗布し乾燥した後に、基材11を重ね合わせて加圧すればよい。さらに、必要に応じて30～80℃の雰囲気で数時間～数日のエージング（養生、硬化）を行って、巻取りロール状の積層体とする。

【0037】

(フォトリソ法) 該積層体の導電材層面へ、レジスト層をメッシュパターン状に設け、レジスト層で覆われていない部分の導電材層をエッティングにより除去した後に、レジスト層を除去するフォトリソグラフィ法で、メッシュ状とする。

(マスキング) まず、基材11と導電材層109の積層体の導電材層109面を、フォトリソグラフィ法でメッシュ状とする。この工程も、帯状で連続して巻き取られたロール状の積層体を加工して行く。該積層体を連続的又は間歇的に搬送しながら、緩みなく伸張した状態で、マスキング、エッティング、レジスト剥離する。

まず、マスキングは、例えば、感光性レジストを導電材層109上へ塗布し、乾燥した後に、所定のパターン（メッシュのライン部）版にて密着露光し、水現像し、硬膜処理などを施し、ベーキングする。

レジストの塗布は、巻取りロール状の帯状の積層体（基材11と導電材層109）を連続又は間歇で搬送させながら、その導電材層109面へ、カゼイン、P

V A、ゼラチンなどのレジストをディッピング（浸漬）、カーテンコート、掛け流しなどの方法で行う。また、レジストは塗布ではなく、ドライフィルムレジストを用いてもよく、作業性が向上できる。ベーキングはカゼインレジストの場合、200～300°Cで行うが、積層体の反りを防止するために、できるだけ低温度が好ましい。

【0038】

（エッティング）マスキング後にエッティングを行う。該エッティングに用いるエッティング液としては、エッティングを連続して行う本発明には循環使用が容易にできる塩化第二鉄、塩化第二銅の溶液が好ましい。また、該エッティングは、帯状で連続する鋼材、特に厚さ20～80 μmの薄板をエッティングするカラーTVのプラウン管用のシャドウマスクを製造する設備と、基本的に同様の工程である。即ち、該シャドウマスクの既存の製造設備を流用でき、マスキングからエッティングまでが一貫して連続生産できて、極めて効率が良い。エッティング後は、水洗、アルカリ液によるレジスト剥離、洗浄を行ってから乾燥すればよい。

【0039】

（メッシュ）メッシュ部103は、ライン107で囲まれた複数で開口部105からなっている。開口部105の形状は特に限定されず、例えば、正方形、長方形、菱形、台形などの4角形、3角形、n角形、円形、橢円形などが適用できる。これらの開口部の複数を、組み合わせてメッシュとする。

【0040】

開口率、メッシュの非視認性、及び画像の視認性から、メッシュ部103のラインの直線部における幅が所定値±30%の範囲内であり、かつ、透明基板と直交したライン切断面の形状における上底と下底とを結ぶ土手の曲率半径が、前記金属箔の厚さの1.5～3.0倍とする。好ましくは、メッシュ部103のライン幅Wが5～25 μmで、ラインとラインのピッチが150～500 μmとし、また、メッシュ部103の外周部の1～50メッシュ、又は0.15～15 mmを除いた部分とする。

【0041】

通常、大型のプラズマディスプレイパネル用の電磁波遮蔽用シートには、数千

本以上の直線ラインが形成されており、そしてそれぞれが交わっている。該ラインのライン幅のバラツキを抑え、かつ、ライン切断面の形状における上底と下底とを結ぶ土手の曲率半径を規制することで、電磁波遮蔽性と適度の透明性を有し、メッシュの濃淡ムラが少なく、かつ、特に黒と白の点状及び線状欠点が少なく、かつまた、表示光のギラツキが少なく、又は外光の反射が抑えられ、優れた画像の視認性を有する電磁波遮蔽用シート1を得ることができる。

【0042】

該ライン幅のバラツキは、例えば、ライン幅 $14 \mu\text{m}$ とすると、 $14 \pm 4.2 \mu\text{m}$ で、範囲としては $9.8 \sim 18.2 \mu\text{m}$ あり、この範囲内であれば、メッシュの濃淡ムラ、黒及び／又は白の点状及び線状の欠点が発生しない。もし、ライン幅に広狭があると、メッシュが濃淡ムラとなる。また広狭が大きい場合には、人間がディスプレイ画像を観察した際に、広い部分は黒点欠点となり、狭い部分は白点欠点となってしまう。全体の画像に対してポツンと白点及び／又は黒点があると、人間は極めて強い違和感を感じる。

【0043】

しかし、本発明の電磁波遮蔽用シートによれば、連続フォトリソグラフィ法で製造し、ライン幅のバラツキを所定の範囲とすることで、メッシュの濃淡ムラの発生は極めて少なく、しかも、電磁波遮蔽性及び透明性には問題はない。また、メッシュの濃淡ムラや黒及び／又は白の点状及び線状の欠点は、レジスト塗布時にレジスト液の飛沫が不要な部分へ付着しても発生するが、連続フォトリソグラフィ法で製造することで、極めてまれである。

【0044】

また、ライン幅の制御からは、メッシュ部103の接地用枠部101に接する部分のメッシュ外周部104の部分を除く。メッシュ外周部104における、ライン107の直線部におけるライン幅Wが、接地用枠部に向かって暫時大きくなるように、ライン幅を暫時拡幅する。

メッシュ外周部104としては、接地用枠部101の内周から $1 \sim 50$ メッシュ、又は $0.15 \sim 1.5 \text{ mm}$ 程度、好ましくは $1 \sim 25$ メッシュ、又は $0.3 \sim 7.5 \text{ mm}$ 、さらに好ましくは $3 \sim 20$ メッシュ、又は $1.5 \sim 6.0 \text{ mm}$ であ

る。これ以上では、ディスプレイの周辺にくま取り状の枠ができて、画像が小さく感じ、また、画像の視認性が低下する。これ未満では、剛度の変化が急激過ぎて、折れ曲がりやすい。また、ライン幅の暫時拡幅は、複数の開口部105（セル）を横断して連続的に拡幅したり、又は開口部105（セル）毎に段階的に拡幅してもよい。

【0045】

図6は、本発明のメッシュ外周部の1部の拡大平面図である。

図6は、メッシュ部103が接地用枠部101と接するメッシュ外周部104の1部を拡大した平面図である。メッシュ部103の所定のライン部107ライン幅をWとし、接地用枠部101に向かって、W1、W2、W3、～Wnとして、 $W < W_1 < W_2 < W_3 < \dots < W_n$ とすればよい。また、ライン幅を連続的に暫時拡幅する場合には、W、W1、W2、W3、～Wnが連続に拡幅し、例えば1セルに対応するライン幅Wnのなかでも暫時拡幅する。ライン幅が段階的に拡幅する場合には、例えば1セルに対応するライン幅Wnのなかでは同じ幅である。また、ライン幅の拡幅は、全部のラインを同一にする必要はなく、ライン毎にW1、W2、W3、～Wnを変えてよい。

【0046】

このようなライン幅を暫時拡幅する方法としては、導電材層109上へ、ドライレジストを貼着、又は感光性レジストを塗布し乾燥した後に、密着露光する所定のパターン版のパターンを変更すればよい。該パターンは、当業者が製版フィルムと呼ぶ、開口部105が不透明、ライン107が透明な製版フィルム（ラインのネガフィルム）である。該ラインの幅を、所定のライン幅をWとし、接地用枠部101に向かって、 $W < W_1 < W_2 < W_3 < \dots < W_n$ とすればよい。

【0047】

また、ラインが電磁波遮蔽用シートの下部面となすバイアス角は、図1の図示では45度を例示しているが、これに限られず、モアレの解消などのために、ディスプレイの画素や発光特性を加味して適宜、選択すればよい。

【0048】

（平坦化）メッシュが形成されると、メッシュのライン部107は金属の厚み

があるが、開口部105は金属箔が除去されて空洞となり、導電材部109は凹凸状態となる。該凹凸は次工程で接着剤又は粘着剤が塗布される場合には、該接着剤などで埋まる。しかし、メッシュ形成後、直ちにディスプレイへ貼り込む場合には、凹凸が露出したままで、作業性が悪いので、凹部を埋めて平坦化することが好ましい。

該平坦化としては、樹脂を凹部に塗布して埋め込むが、凹部の隅々まで侵入しないと、気泡が残り透明性が劣化する。このため、溶剤などで稀釈して低粘度で塗布し乾燥したり、空気を脱気しながら塗布したりして、平坦化層29を形成する。

【0049】

平坦化層29は透明性が高く、メッシュ剤との接着性が良く、次工程の接着剤との接着性がよいものであればよい。但し、平坦化層29の表面が、突起、凹み、ムラがあると、ディスプレイ前面へ設置した際に、モワレ、干渉ムラ、ニュートンリングが発生したりするので好ましくない。好ましい方法としては、樹脂として熱又は紫外線硬化樹脂を塗布した後に、平面性に優れ剥離性のある基材で積層し、塗布樹脂を熱又は紫外線で硬化させて、剥離性基材を剥離し除去する。平坦化層29の表面は、平面性基材の表面が転写されて、平滑な面が形成される。

該平坦化層29に用いる樹脂としては、特に限定されず各種の天然又は合成樹脂、熱又は電離放射線硬化樹脂などが適用できるが、樹脂の耐久性、塗布性、平坦化しやすさ、平面性などから、アクリル系の紫外線硬化樹脂が好適である。

【0050】

(NIR層) さらに、平坦化層29に用いる樹脂へ、可視及び／又は近赤外線の特定波長を吸収する光線吸収剤を添加してもよい。可視及び／又は近赤外線の特定波長を吸収することで、不快感が抑えられ、画像の視認性が向上する。可視及び／又は近赤外線の特定波長とは、780～1100nm程度である。該780～1000nmの波長領域の80%以上を吸収することが望ましい。該近赤外線吸収剤(NIR剤という)としては、特に限定されないが、近赤外線領域に急峻な吸収があり、可視光領域の光透過性が高く、かつ、可視光領域には特定の波長の大きな吸収がない色素などが適用できる。PDPディスプレイから発光する

可視光領域としては、通常、ネオン光であるオレンジ色が多いので、780～900 nm付近をある程度吸収ものが好ましい。該色素としては、シアニン系化合物、フタロシアニン系化合物、ナフタロシアニン系化合物、ナフトキノン系化合物、アントラキノン系化合物、ジチオール系錯体などがある。平坦化層29～NIR剤を添加したが、添加しない場合には、NIR剤を有する別の層（NIR層という）を、少なくとも一方の面へ設ければよい。

【0051】

（NIR別層）NIR層は、平坦化層29側及び／又は逆側の基材11側へ設け、平坦化層29面へ設けた場合は、図1に図示するNIR層31Bで、基材1面へ設けた場合は、図1に図示するNIR層31Aである。該NIR層31B及びNIR層31Aは、NIR剤を有する市販フィルム（例えば、東洋紡績社製、商品名No.2832）を接着剤で積層したり、先のNIR剤をバインダへ含有させて塗布してもよい。該バインダとしては、ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、アクリル樹脂や、熱又は紫外線などで硬化するエポキシ、アクリレート、メタアクリレート、イソシアネート基などの反応を利用した硬化タイプなどが適用できる。

【0052】

（AR層）さらに、図示していないが、電磁波遮蔽用シートの観察側へ、反射防止層（AR層という）を設けてよい。反射防止層は、可視光線をの反射を防止するためのもので、その構成としては、単層、多層の多くが市販されている。多層のものは、高屈折率層と低屈折率層を交互に積層したもので、高屈折率層としては、酸化ニオブ、チタン酸化物、酸化ジルコニウム、ITOなどがあり、低屈折率層としては、珪素酸化物がある。また、外光を乱反射する微細な凹凸表面を有する層を有するものもある。

【0053】

（ハードコート層、防汚層、防眩層）さらに、反射防止（AR）層には、ハードコート層、防汚層、防眩層を設けてよい。ハードコート層は、JIS-K5400の鉛筆硬度試験でH以上の硬度を有する層で、ポリエステルアクリレート、ウレタンアクリレート、エポキシアクリレートなどの多官能アクリレートを、

熱又は電離放射線で硬化させる。防汚層は、撥水性、撥油性のコートで、シロキサン系、フッ素化アルキルシリル化合物などが適用できる。防眩層は外光を乱反射する微細な凹凸表面を有する層である。

【0054】

(シート化) 以上のように、連続した帯状の巻取りロール状態で製造してきた部材を切断して、1枚毎の電磁波遮蔽用シート1を得る。該電磁波遮蔽用シート1を、ガラスなどの透明な基板へ貼り付けられ、また必要に応じて、NIR層、AR層、ハードコート層、防汚層、防眩層と組み合されてディスプレイ前面板となる。該基板は、大型のディスプレイには厚さが1~10mmの剛性を持つものが、また、キャラクタ表示管などの小型のディスプレイには厚さが0.01~0.5mmのプラスチックフィルムが用いられ、ディスプレイの大きさや用途に応じて、適宜選択すればよい。ここでは、電磁波遮蔽用シート1を一旦ディスプレイ前面板としてから、ディスプレイの前面へ設置したので、基材11側が観察側となっているが、スプレイの前面へ直接貼着してもよい。

【0055】

図6は、ディスプレイ面へ貼着する本発明の電磁波遮蔽用シートの断面図である。

(直接貼着) この場合には、メッシュ状となった金属箔側が観察側となり、該金属箔側へ少なくとも黒化処理、防錆層を必須に設ければよい。接地用枠部101が表面へ露出するので、電極を引き出し易くアースがとりやすい。また、該接地用枠部101が黒化処理されていて黒い面が観察側となるので、前面ガラス板の額縁状に設けていた黒色印刷が不要となり、工程が短縮でき、コスト面でも有利である。

【0056】

【実施例】

(実施例1) 導電材として、平均粒子径0.3μmの銅-コバルト合金粒子、クロメート(処理)層が付加された厚さ10μmの電解金属箔を用いて、この銅-コバルト合金粒子のクロメート(処理)層面と、厚さが100μmのPETフィルムA4300(東洋紡績社製、ポリエチレンテレフタレート商品名)とを、

ポリウレタン系接着剤でラミネートした後に、56°Cで4日間エージングした。接着剤としては主剤タケラックA-310と硬化剤A-10（いずれも武田薬品工業社製、商品名）を用い、塗布量は乾燥後の厚さで7μmとした。

フォトリソグラフィ法によるメッシュの形成は、連続した帯状でマスキングからエッティングまでを行う、カラーTVシャドウマスク用の製造ラインを流用した。まず、導電材層面の全体へ、カゼインレジストを掛け流し法で塗布した。次のステーションへ搬送し、下記の形状を有するパターン版を用いて、密着露光した。次々とステーションを搬送しながら、水現像し、硬膜処理し、さらに、100°Cでベーキングした。

上記パターン版の形状は、メッシュ部の開口部が正方形でライン幅22μm、ライン間隔（ピッチ）300μm、バイアス角度49度で、かつ5mm幅のメッシュ外周部を有し、該メッシュ外周部のライン幅を22μmから接地用枠部へ向かって連続的に増加させて、接地用枠部と接する部分で40μmとし、接地用枠部（アース部）の幅は5mmとした。

さらに次のステーションへ搬送し、エッティング液として40°C、40°ボーメの塩化第二鉄溶液を用いて、スプレイ法で吹きかけてエッティングし、開口部を形成した。次々とステーションを搬送しながら、水洗し、レジストを剥離し、洗浄し、さらに、100°Cで乾燥して実施例1の電磁波遮蔽用シートを得た。

【0057】

（比較例1）パターン版の形状として、メッシュ部の開口部が正方形でライン幅22μm、ライン間隔（ピッチ）300μm、バイアス角度49度で、接地用枠部まで同じライン幅22μmとした以外は、実施例1と同様にして、比較例1の電磁波遮蔽用シートを得た。

【0058】

（実施例2）実施例1のメッシュ部へ、下記組成の平坦化層組成物を塗布し、厚さが50μmのSP-PET20-BU（トーセロ社製、表面離型処理PETフィルム商品名）をラミネートした後に、高圧水銀灯を用いて200mJ/cm²の露光（365nm換算）した。そして、SP-PET20-BUを剥離すると、メッシュ部が平坦化した実施例2の電磁波遮蔽用シートが得られた。該電磁

波遮蔽用シートは、実施例1と同様の性能を有していた。

平坦化層組成物としては、N-ビニル-2-ピロリドン20質量部、ジシクロペニテニルアクリレート25質量部、オリゴエステルアクリレート（東亜合成（株）製、M-8060）52質量部、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン（チバガイギー社製、イルガキュア184）3質量部を用いた。

【0059】

（実施例3）実施例2の平坦化層組成物へ、チオールニッケル錯体1質量部を含有させた以外は、実施例2と同様にして電磁波遮蔽用シートを得た。該電磁波遮蔽用シートとしては、実施例1と同様の性能を有し、ディスプレイ画像の視認性はさらに良かった。

【0060】

（実施例4）実施例2の平坦化層面へ、NIRフィルムNo2832（東洋紡績社製、近赤外線吸収フィルム商品名）を粘着剤で積層した以外は、実施例2と同様にして電磁波遮蔽用シートを得た。該電磁波遮蔽用シートとしては、実施例1と同様の性能を有し、ディスプレイ画像の視認性はさらに良かった。

【0061】

（実施例5）

上記パターン版の形状として、メッシュ部の開口部が正方形でライン幅20μm、ライン間隔（ピッチ）250μm、バイアス角度60度で、かつ5mm幅のメッシュ外周部を有し、該メッシュ外周部のライン幅を20μmから接地用枠部へ向かって連続的に増加させて、接地用枠部と接する部分で26μmとする以外は、実施例1と同様にして、実施例5の電磁波遮蔽用シートを得た。

【0062】

（実施例6）

上記パターン版の形状として、メッシュ部の開口部が正方形でライン幅20μm、ライン間隔（ピッチ）250μm、バイアス角度60度で、かつ3mm幅のメッシュ外周部を有し、該メッシュ外周部のライン幅を20μmから接地用枠部へ向かって連続的に増加させて、接地用枠部と接する部分で26μmとする以外は、実施例1と同様にして、実施例6の電磁波遮蔽用シートを得た。

【0063】

(実施例7)

上記パターン版の形状として、メッシュ部の開口部が正方形でライン幅 $20\mu m$ 、ライン間隔（ピッチ） $300\mu m$ 、バイアス角度49度で、かつ25メッシュのメッシュ外周部を有し、該メッシュ外周部のライン幅を $20\mu m$ から接地用枠部へ向かって1セル毎に $1.0\mu m$ づつ増加させて、接地用枠部と接する部分で $45\mu m$ とする以外は、実施例1と同様にして、実施例7の電磁波遮蔽用シートを得た。

【0064】

(実施例8)

上記パターン版の形状として、メッシュ部の開口部が正方形でライン幅 $20\mu m$ 、ライン間隔（ピッチ） $300\mu m$ 、バイアス角度49度で、かつ5メッシュのメッシュ外周部を有し、該メッシュ外周部のライン幅を $20\mu m$ から接地用枠部へ向かって1セル毎に $3.0\mu m$ づつ増加させて、接地用枠部と接する部分で $35\mu m$ とする以外は、実施例1と同様にして、実施例8の電磁波遮蔽用シートを得た。

【0065】

(実施例9) 銅-コバルト合金粒子のクロメート（処理）層でない面と、PETフィルムをラミネートする以外は、実施例1と同様にし、さらに、実施例2と同様にして平坦化層を形成して、実施例9の電磁波遮蔽用シートを得た。

【0066】

(結果) 実施例1では、メッシュ部のライン幅 $22\mu m$ のレジストパターン版を用いたが、エッチング後のメッシュ部のライン幅は $7\sim17\mu m$ となり、メッシュ外周部のライン幅はメッシュ部と接する部分が $7\sim17\mu m$ で、接地用枠部に接する部分が $17\sim29\mu m$ であった。比較例1では、エッチング後のメッシュ部のライン幅はメッシュ部と接する部分から接地用枠部に接する部分までが $10\sim16\mu m$ であったが、接地用枠部に接する部分では、 $5\sim20\mu m$ とバラツキが大きかった。

また、実施例1及び比較例1の電磁波遮蔽用シートを各100枚を用いて、実

施例2に順じて平坦化層を形成したところ、実施例1では100枚とも異常なく組立てられたが、比較例1では断線が2枚発生し、歩留まりが低かった。

【0067】

さらに、実施例1及び比較例1の電磁波遮蔽用シートを各100枚を用いて、PDPパネルへ組立てたところ、実施例1では100枚とも異常なく組立てられたが、比較例1では折れが1枚、断線が1枚発生し、歩留まりが低かった。なお、実施例1～実施例8及び比較例1の電磁波遮蔽用シートを前面板へ加工し、PDPディスプレイの前面へ設置して、画像を表示させて視認性を評価したところ、いずれも視認性は良好であった。また、実施例9の電磁波遮蔽用シートの基材面を粘着剤でPDPディスプレイへ設置したところ、ギラツキもなく、画像の視認性は良好で、さらに電極の引き出し工数も減り、額縁状の黒印刷も要らなかつた。

【0068】

【発明の効果】

本発明の電磁波遮蔽用シートによれば、メッシュ部103が接地用枠部101と接するメッシュ外周部104における、ライン107の直線部におけるライン幅Wが、接地用枠部に向かって暫時大きくなるようにする電磁波遮蔽用シートによれば、ディスプレイから発生する電磁波を遮蔽し、かつ、メッシュのライン部分は非視認性で、電磁波遮蔽性、透明性の両特性を満たし、かつ、ライン幅の乱れがなく、ディスプレイ画像にギラツキ感がなく、画像の視認性が著しく向上する。

また、該メッシュ外周部104は、接地用枠部の内周から1～50メッシュ、又は0.15～15mm程度、好ましくは1～25メッシュ、又は0.3～7.5mm、さらに好ましくは3～20メッシュ、又は1.5～6.0mmとし、ライン幅の暫時拡幅は、連続的、又は段階的でもよい。このようにすると、メッシュ外周部104と接地用枠部101とで極端に違う剛度が、徐々に変化することで大幅に緩和される。電磁波遮蔽用シートの製造工程からディスプレイへの組立、組付まで全工程において、ハンドリング適性が極めてよく、折れ曲がったり、折りくせが発生せず、高価な部品を無駄にすることがない。

さらに、本発明の電磁波遮蔽用シートは、基材面をPDPディスプレイへ設置してもよく、電極の引き出し工数も減り、額縁状の黒印刷も要らず、画像の視認性はギラツキもなく、良好である。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の電磁波遮蔽用シートの平面図である。

【図2】 本発明の電磁波遮蔽用シートの一部を模式的に示す斜視図である

。 【図3】 図2のAA断面図、及びBB断面図である。

【図4】 導電材層の構成を説明する断面図である。

【図5】 卷取りロール状での加工を説明する平面図及び側面図である。

【図6】 本発明のメッシュ外周部の1部の拡大平面図である。

【図7】 ディスプレイ面へ貼着する本発明の電磁波遮蔽用シートの断面図

である。

【符号の説明】

1 電磁波遮蔽用シート

1 1 基材

1 3 接着剤層

2 1 金属箔

2 3 A、2 3 B 銅 - コバルト粒子

2 5 A、2 5 B 防錆層

2 9 平坦化層

3 1 A、3 1 B N I R層

1 0 1 接地用枠部

1 0 3 メッシュ部

1 0 5 開口部

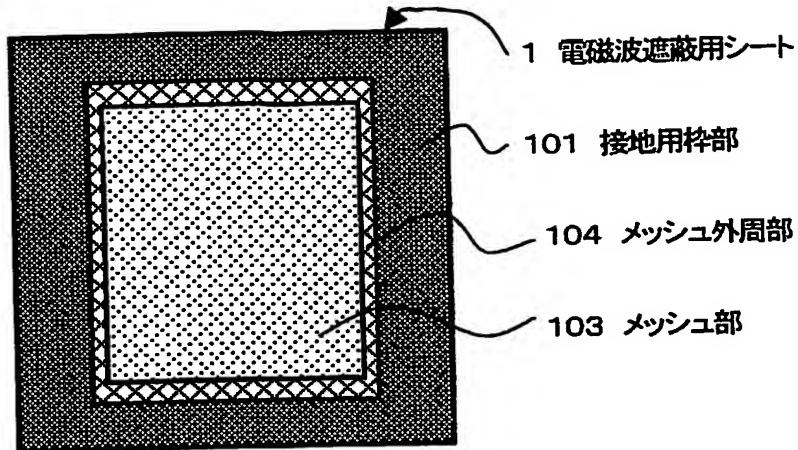
1 0 7 ライン部

1 0 9 導電材部

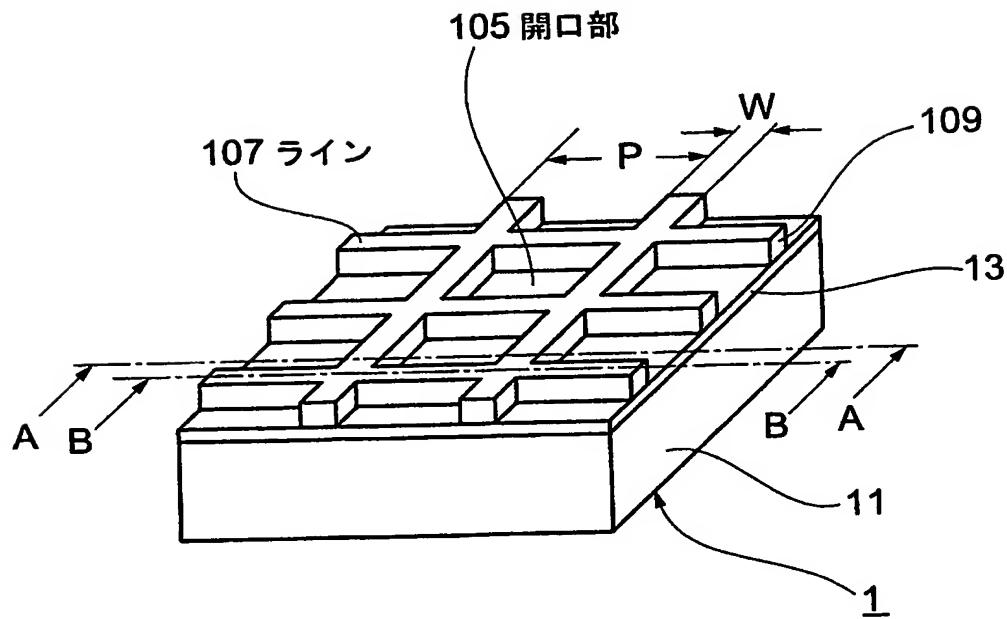
【書類名】

図面

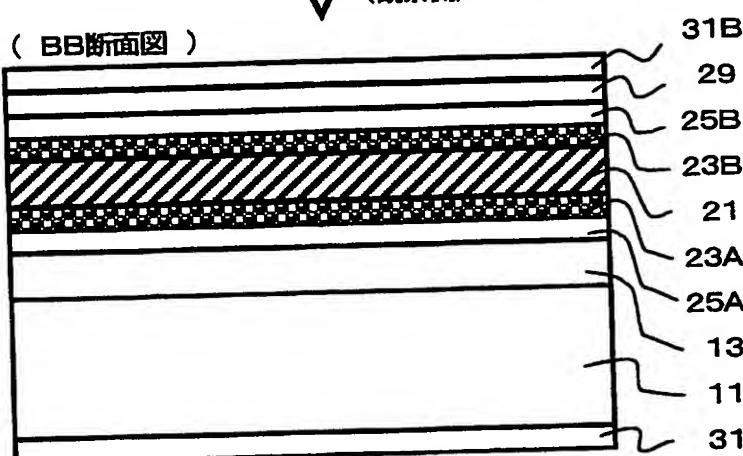
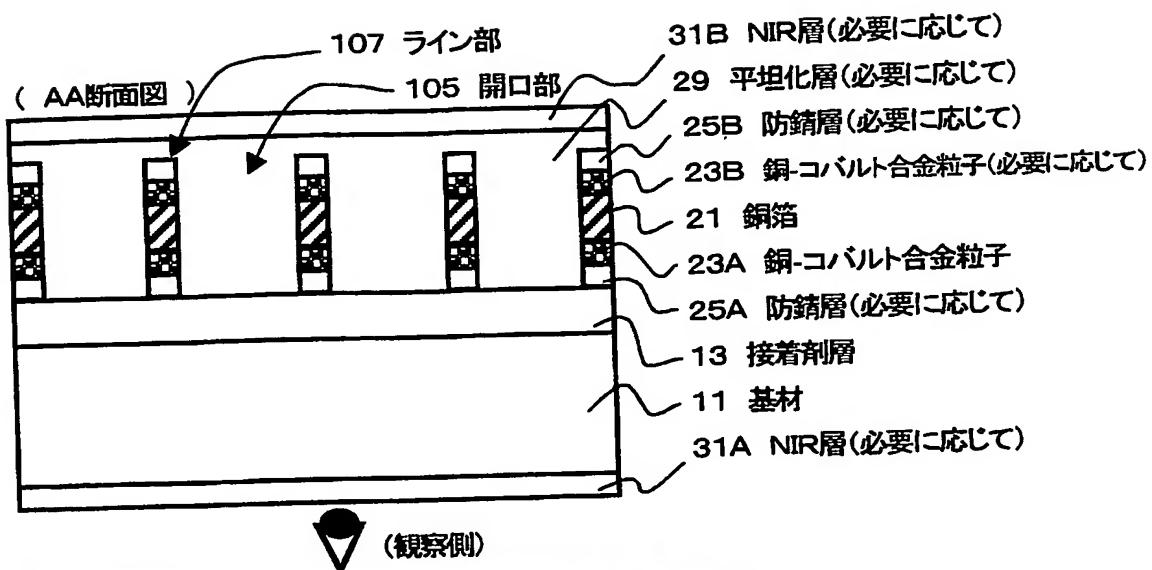
【図 1】



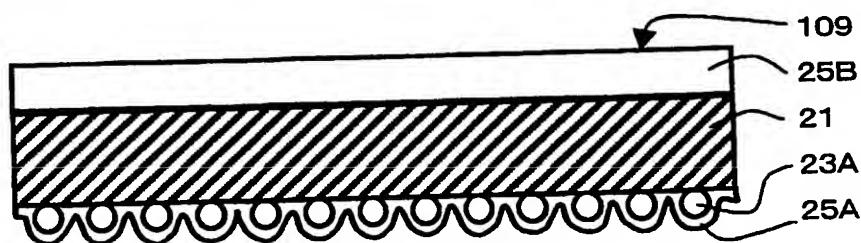
【図 2】



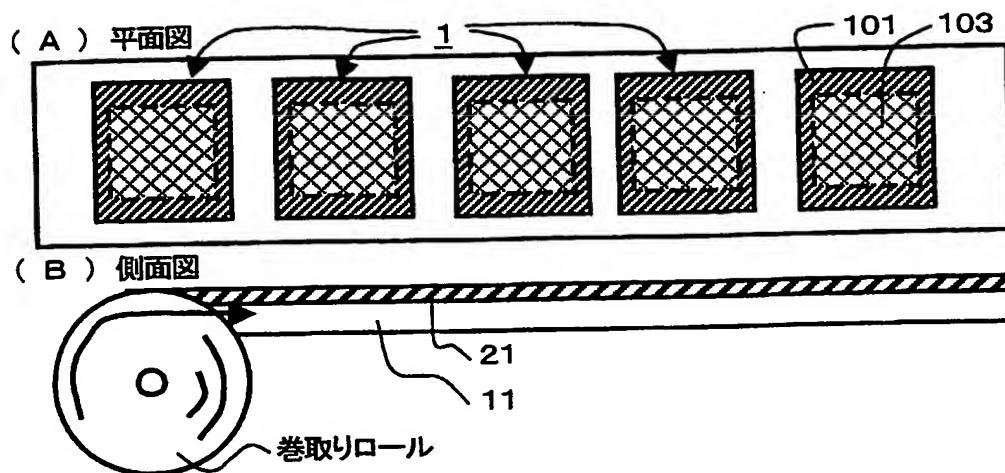
【図3】



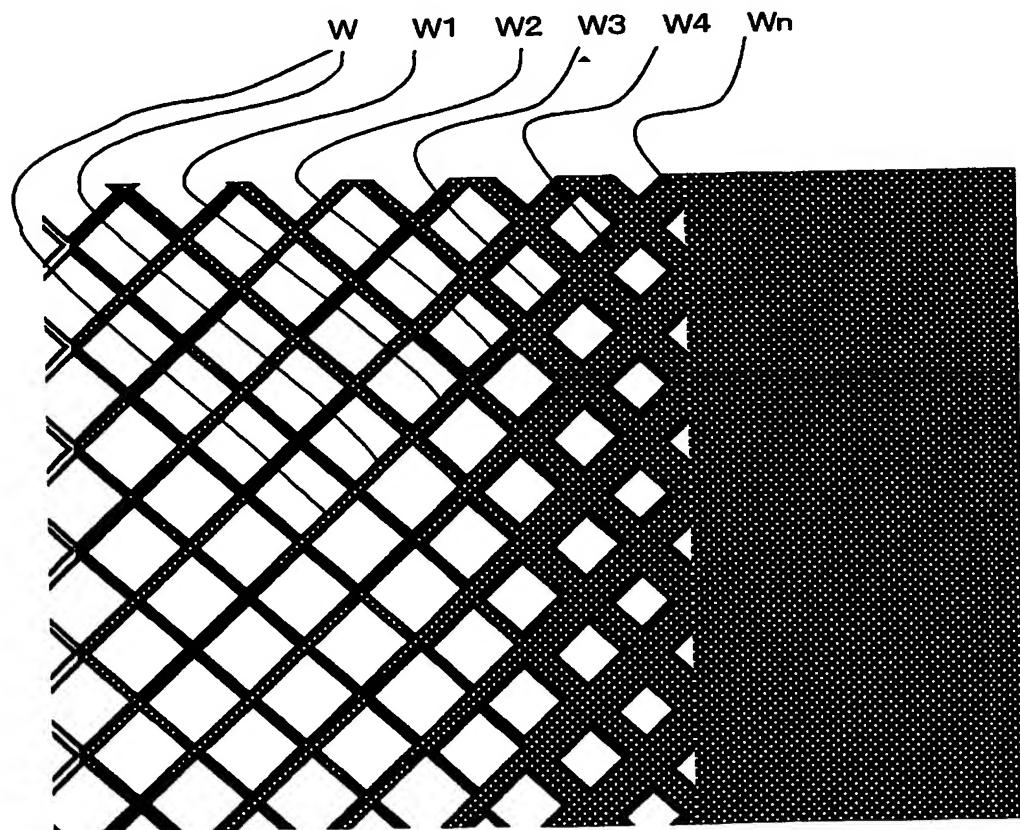
【図4】



【図5】

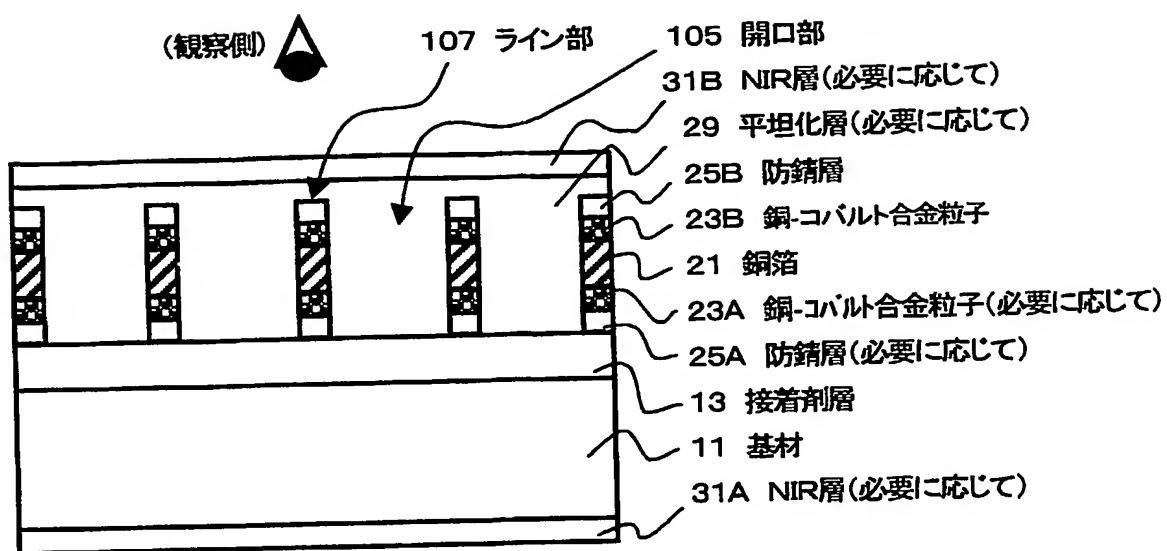


【図6】



BEST AVAILABLE COPY

【図 7】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】

ディスプレイから発生する電磁波を遮蔽し、メッシュの乱れがなくて、ディスプレイ画像を良好に視認性でき、かつまた、大型の電磁波遮蔽用シートでも、製造から組立までの全工程で折れや断線などの不良が発生せず、ハンドリング適性に優れた電磁波遮蔽用シートを提供する。

【解決手段】

透明基材の一方の面へ、接着剤、メッシュ外周部を有するメッシュ部と接地用枠部とを有する金属箔が積層された電磁波遮蔽用シートにおいて、前記メッシュ外周部のラインのライン幅が、接地用枠部に向かって暫時拡幅する、また、前記メッシュ外周部が接地用枠部の内周から1～50メッシュ、又は0.15～1.5mm程度、好ましくは1～25メッシュ、又は0.3～7.5mm、さらに好ましくは3～20メッシュ、又は1.5～6.0mmであり、かつ、前記ライン幅の暫時拡幅が、連続的、又は段階的であることを特徴とする。

【選択図】 図1

特願 2002-230844

出願人履歴情報

識別番号 [000002897]

1. 変更年月日 1990年 8月27日

[変更理由] 新規登録

住所 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
氏名 大日本印刷株式会社